

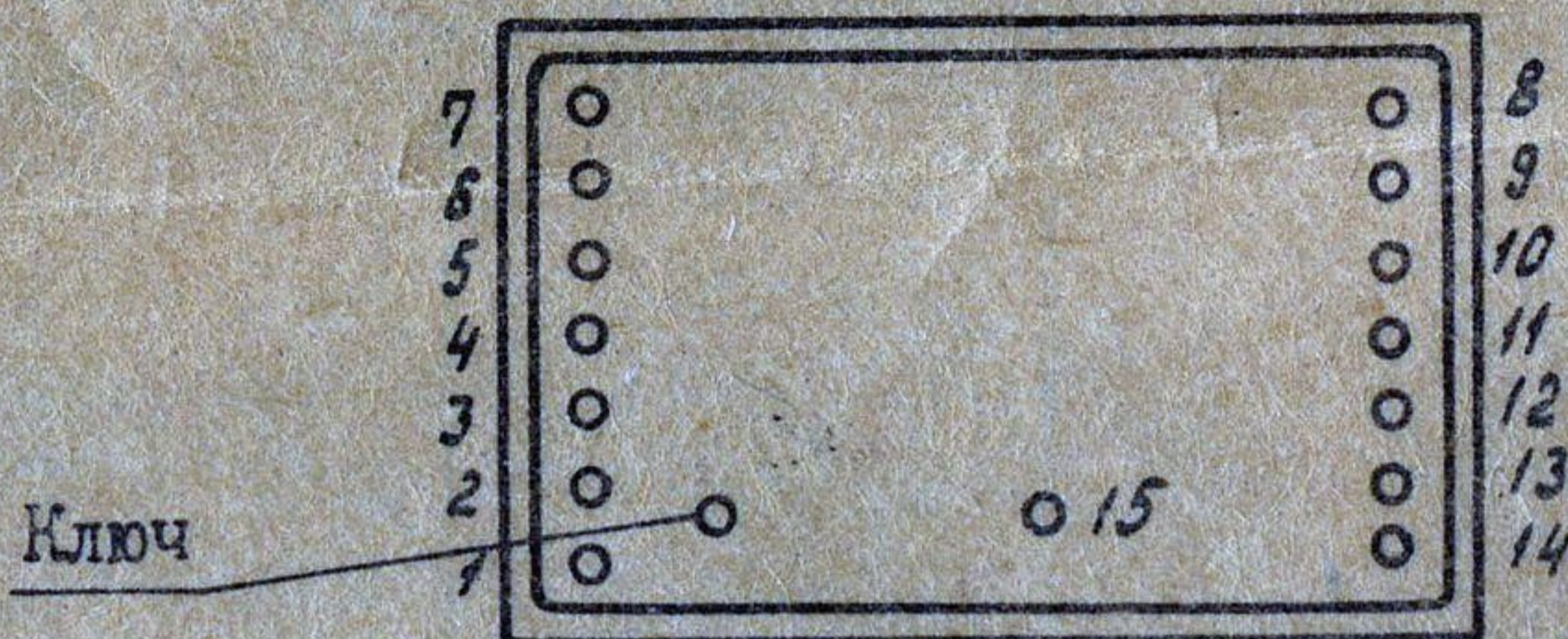


ЭТИКЕТКА

Гибридные интегральные микросхемы К298ФВ1-К298ФВ21 - фильтры верхних частот.

Климатическое исполнение УХЛ категорий 2 и В категории 2.

Схема расположения выводов



Масса не более 7 г
(в корпусе 155.15-1)

Масса не более 8,3 г
(в корпусе 155.15-2)

Таблица назначения выводов

Конт.	Цепь	Конт.	Цепь
1	Вход	10	Выход
7	Общий	14	Питание минус 6 В
8	Питание 6 В	15	Корпус
9	Питание 12 В	2,3,4,5,6, 11,12,13	Свободный

Основные электрические параметры при поставке
(при температуре 25°C)

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Типономи-нал	Норма	Примечание
Нижняя граничная частота полосы пропускания, Гц	К293ФВ1	97 - 103	
	К298ФВ2	121,3-128,7	
	К298ФВ3	155,2-164,8	
	К298ФВ4	194 - 206	

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Типономинал	Норма	Примечание		
Нижняя граничная частота полосы пропускания, Гц	K298ФВ5	242,5-257,5	1,5,6		
	K298ФВ6	305,6-324,4			
	K298ФВ7	388-412			
	K298ФВ8	485 - 515			
	K298ФВ9	582 - 618			
	K298ФВ10	776 - 824			
	K298ФВ11	970 - 1030			
	K298ФВ12	1213 - 1287			
	K298ФВ13	1552 - 1648			
	K298ФВ14	1892 - 2008			
	K298ФВ15	2425 - 2575			
	K298ФВ16	3056 - 3244			
	K298ФВ17	3783 - 4017			
	K298ФВ18	4850 - 5150			
	K298ФВ19	6111 - 6489			
	K298ФВ20	7760 - 8240			
	K298ФВ21	9700 - 10300			
	Коэффициент усиления напряжения	K298ФВ1- K298ФВ21		0,90 -1,10	1;6
	Коэффициент неравномерности АЧХ, дБ, не более			2,0	2;6
	Коэффициент прямоугольности, не более			1,9	3
Коэффициент ослабления в полосе задержания, дБ, не менее	50		4		
Приведенное ко входу напряжение шумов, эфф., мкВ, не более	250				
Коэффициент гармоник, %, не более	2,0		1;7		
Ток потребления, мА, не более при $U_{cc} = 13,2$ В при $U_{cc} = \text{минус } 6,6(+6,6)$ В	2,0 1,4				
Параметры режима: Напряжение питания, В	10,8-13,2 5,4-6,6 минус 5,4 - минус 6,6				

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Типономинал	Норма	Примечание
Сопротивление нагрузки, кОм	K298ФВ1-	27 - 33	
Разделительная емкость, мкФ	K298ФВ21	16 - 24	
Внутреннее сопротивление звукового генератора, Ом		540 - 660	

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Для микросхем K298ФВ1 - K298ФВ3 при частоте входного сигнала (f_s) равном (240 ± 5) Гц,
 для микросхем K298ФВ4-K298ФВ6 при $f_s = (500 \pm 10)$ Гц,
 для микросхем K298ФВ7-K298ФВ8 при $f_s = (800 \pm 16)$ Гц,
 для микросхем K298ФВ9-K298ФВ11 при $f_s = (1500 \pm 30)$ Гц,
 для микросхем K298ФВ12-K298ФВ13 при $f_s = (2500 \pm 50)$ Гц,
 для микросхем K298ФВ14-K298ФВ16 при $f_s = (5000 \pm 100)$ Гц,
 для микросхем K298ФВ17 при $f_s = (8000 \pm 160)$ Гц,
 для микросхем K298ФВ18-K298ФВ19 при $f_s = (10000 \pm 200)$ Гц,
 для микросхем K298ФВ20 при $f_s = (15000 \pm 300)$ Гц,
 для микросхем K298ФВ21 при $f_s = (20000 \pm 400)$ Гц.

2. Для микросхем K298ФВ1-K298ФВ10 при частоте входного сигнала от f 0,9 до 10 кГц;

для микросхем K298ФВ11-K298ФВ21 при частоте входного сигнала от f 0,9 до 30 кГц.

3. При частоте входного сигнала f 50 дБ.

4. При частоте входного сигнала от $0,3 f_L$ до $0,5 f_L$.

5. При выходном напряжении 1414 мВ.

6. При входном напряжении (1,8 - 2,2) В и выходном напряжении (2000 ± 10) мВ.

7. При входном напряжении (2000 ± 10) мВ.

Содержание драгоценных металлов в одной микросхеме:
 золото

Содержание цветных металлов в одной микросхеме:

сплав 29НК - 4,3 г в корпусе 155.15-1,

сплав 47НД - 7,9 г в корпусе 155.15-2.

Сведения о приемке

Микросхемы К298ФВ1-К298ФВ21 соответствуют бкО.348.367 ТУ.

Приняты по извещению № _____ от _____

Штамп ОТК

ОТК-780

Штамп

Государственной приемки

Штамп "Перепроверка произведена _____"

Приняты по извещению № _____ от _____

Штамп ОТК

Штамп

Государственной приемки

Указания по эксплуатации

1. Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки или паяльником.
2. Температура пайки $(235 \pm 5)^\circ\text{C}$, расстояние от корпуса до места пайки $1,5^{+0,3}_{-0,1}$ мм, продолжительность пайки 2,5 с.
3. Микросхемы устанавливают на платы с дополнительной жесткой прокладкой толщиной 1,0 мм. Крепление прокладки к микросхеме и плате производить клеем АК-20 ТУ6-10-1293-78 или любым клеящим материалом, обеспечивающим необходимую прочность. Крепление прокладки к микросхеме и плате обязательно по всей поверхности прокладки.
4. Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов (в том числе шин "ПИТАНИЕ" и "ЗЕМЛЯ") к неиспользуемым выводам микросхемы.
5. Установку и извлечение микросхем с платы или контактирующих устройств производить при отключенном источнике питания.
6. Ультразвуковая очистка от флюса не допускается.
7. Для выпайки микросхем из печатной платы рекомендуется применять электропаяльник с насадкой для групповой выпайки, обеспечивающий одновременный нагрев всех выводов. Число допустимых перепаек выводов микросхем при проведении монтажных операций два.
8. Допустимое значение статического потенциала 500 В.